成都市经济和信息化局

关于做好2025年度成都市集成电路项目申报

工作的通知

四川天府新区智能制造局、成都东部新区战略研究局、成都高新区电子局、各区（市）县工业和信息化主管部门：

根据《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策》（成经信发〔2023〕4号）、《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策实施细则》（成经信办〔2023〕17号），现将2025年度成都市集成电路项目申报工作有关事项通知如下。

一、项目类别

2025年度成都市集成电路项目分为集成电路人才政策、集成电路设计业政策、集成电路制造业政策、完善产业生态环境政策四个大类，共计15个申报子类别（见附件1）。

二、支持范围

（一）申报主体

2025年度成都市集成电路项目申报主体为在我市具有独立法人资格的从事集成电路产业相关业务的企事业单位及机构（行业协会、民非组织、产业基金），以及符合条件的在蓉高校、科研院所及有关人才。

（二）时间范围

项目认定时间应在2024年1月1日至2024年12月31日内，项目认定时间以项目开具的相关发票时间为准。

（三）流片重点支持方向

本年度对全掩膜（FullMask）首轮工程产品流片的重点支持方向为：线宽小于28纳米（含）的硅基集成电路项目，线宽小于0.15微米（含）的化合物集成电路项目。

三、申报流程

本次成都市集成电路项目中“对企业人力资源成本支出超过30万元的集成电路企业高级管理人才和研发人才给予最高不超过50万元奖励”条款由申报单位所在区（市）县集成电路产业链牵头部门牵头做好通知、受理、审核和资金兑付工作。

本次成都市集成电路项目其余项目大类由申报单位通过“天府蓉易享”平台进行网上申报，具体流程如下。

（一）申报单位线上申报

各区（市）县组织属地申报单位于2025年6月30日至2025年7月18日进行线上申报（网址：https://tfryx.tfryb.com/，平台首页右上角附操作指引，平台问题可拨打技术咨询电话：028-63911260）。

（二）区（市）县线上审核

各区（市）县于2025年7月23日17:00前完成申报材料线上审核，并将成都市集成电路项目资金申报统计汇总表（附件17）以正式行文报送我局，电子版同步报送至邮箱elec\_CD@163.com。

（三）线下提交纸质材料

经区（市）县审核通过的项目，请于2025年7月23日前将经区（市）县盖章的纸质版申报书（一式一份）报送至市经信局。

四、工作要求

（一）严格压实主体责任

1. 申报单位应严格按照项目申报书编制说明填报申报书，并对申报项目内容的真实性、申报材料完整性、申报项目重复性负主体责任；

2. 申报单位在申报过程中应严格遵守国家保密法律法规，申报材料均需脱密。

（二）切实履行属地责任

1. 各区（市）县要高度重视此次集成电路项目申报工作，明确专人，落实责任，严格把关，切实履行项目申报组织、材料审核、现场核查相关责任。

2. 各区（市）县要加强政策宣传，认真掌握实施细则，指导企业做好申报工作，确保用好用足政策。

五、其他事项

1. 为加强项目资金的绩效管理，提高资金使用效益，本申报指南中的项目，项目补助（支持）资金低于10万元（不含10万元）的不纳入补助（支持）范围，认定的金额不含增值税（进项税）。

2．申报单位提供的复印件均须加盖本单位公章，并整理好原件备查。

3．同一项目不重复享受同类政策补助（奖励），项目单位不得将同一项目多头重复申报，同一项目申报了中央、省补助资金或申报了多项市级专项资金的，应当在专项资金申报材料中说明已获得或正在申报的补助资金情况。

（申报系统技术人员联系电话：028-63911260

政策咨询人员：杨盛凯；联系电话：028-61881637）

附件：

1．项目申报分类对照表

2．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-1给予集成电路设计企业核心团队奖励事项）

3．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-2给予集成电路晶圆制造、封测等企业核心团队奖励事项）

4．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-3给予集成电路装备、材料等企业核心团队奖励事项）

5．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-4入选“中国芯”优秀产品奖励）

6．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-5支持高校开展示范性微电子学院和“集成电路科学与工程”一流学科建设）

7．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：1-6鼓励集成电路企业或行业组织与高校开展产教融合）

8．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：2-1支持企业从事集成电路IP核和EDA工具研发）

9．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：2-2支持集成电路设计企业购买IP核、EDA工具、测试设备用于芯片研发）

10．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：2-3鼓励企业加大Full mask全掩膜流片投入力度事项）

11．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：2-4鼓励企业和高校科研院所加大MPW流片投入力度事项）

12．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：3-1鼓励晶圆制造产线为设计企业提供代工流片服务）

13．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：3-2鼓励封装测试产线为设计企业提供封装测试服务）

14．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：4-1鼓励集成电路公共服务平台新增投资）

15．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：4-2鼓励集成电路公共服务平台为企业提供服务）

16．成都市集成电路项目资金申报书（子项目类别：4-3支持集成电路行业组织为企业搭建要素对接平台）

17．成都市集成电路项目资金申报统计汇总表

                   成都市经济和信息化局

     2025年6月24日